

株主メモ

事業年度	毎年4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会	毎年6月開催
基準日	期末配当金 毎年3月31日 中間配当金 毎年9月30日 そのほか必要があるときは、あらかじめ公告して定めた日
単元株式数	100株
株主名簿管理人および 特別口座の口座管理機関	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社
株主名簿管理人 同事務取扱場所 (郵便物送付先)	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 〒168-0063東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
(電話照会先)	☎0120-782-031
(インターネットホームページURL)	https://www.smtb.jp/personal/procedure/agency/
公告の方法	当社のホームページに掲載する https://www.ferrotec.co.jp/
上場証券取引所	株式会社東京証券取引所 スタンダード

・株主に関する住所変更等のお届出およびご照会について

証券会社の口座をご利用の場合は、三井住友信託銀行ではお手続きができませんので、取引証券会社へご照会ください。証券会社の口座のご利用がない株主様は、上記電話照会先までご連絡ください。

年間IRカレンダー

第2 四半期			第3 四半期			第4 四半期			第1 四半期		
7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月
第1四半期開示			中間決算	中間決算発表 中間決算説明会		第3四半期開示		本決算		決算発表 決算説明会	株主総会

Ferro Tec

株式会社 フェローテック ホールディングス

〒103-0027

東京都中央区日本橋2-3-4 日本橋プラザビル5階

TEL 03-3281-8808 FAX 03-3281-8848

URL <https://www.ferrotec.co.jp/>

2025年7月1日より

株式会社フェローテック

に変わります。

UD FONT

見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。



森林に配慮して適切に管理された森林認証紙を使用しています。



環境に配慮した植物油インキを使用しています。

第45期 決算報告

2024年4月1日～2025年3月31日

証券コード：6890



Ferro Tec

株式会社 フェローテック ホールディングス

株主の皆さまへ



代表取締役社長
グループCEO
賀 賢漢

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
ここに第45期決算報告をお届けするにあたりご挨拶申し上げます。

第45期は、生成AI成長に伴うサーバー投資も好調を維持したほか、中国の旺盛な需要が引き続き市場を牽引、欧米需要も昨年からの回復により全体では堅調でした。パワー半導体分野も、主要用途である電気自動車(EV)市場で中国の販売台数が伸びるなど引き続き好調であり、下期に太陽光パネル向け市場が停滞したものの、今期も前期を上回る創業来過去最高の売上高をあげることができました。また、生産面では米中半導体摩擦に伴うリスク緩和を目指し建設したマレーシア北部クリム工場で順調に生産を立ち上げ、同時にマレーシア南部のジョホール工場、日本の熊本、石川の工場建設を進めることができました。また、中国でもセンサ事業の世界戦略の拠点となる麗水工場、洗浄事業の青島工場も順調に建設を進めることができました。

今年に入り米国新政権による関税政策をはじめとする政策の不確実性の高まりがあるものの、当社グループは将来にわたり成長が期待される半導体需要の取り込みを継続し、力強い成長を志向してまいります。同時に株価を意識した経営を実践するべく、配当方針の変更(株主資本配当率の採用)に伴う増配や自己株買取などを進めてまいります。

また2025年7月1日から、成長のための新体制として、当社は事業子会社である株式会社フェローテックマテリアルテクノロジーと合併し、純粋持株会社から事業会社へと移行します。これに伴い商号を株式会社フェローテックホールディングスから「株式会社フェローテック」に変更することといたしました。

これら施策を進めてこれましたのも、ひとえに株主の皆さまのご理解、ご支援の賜物であると感謝いたしております。

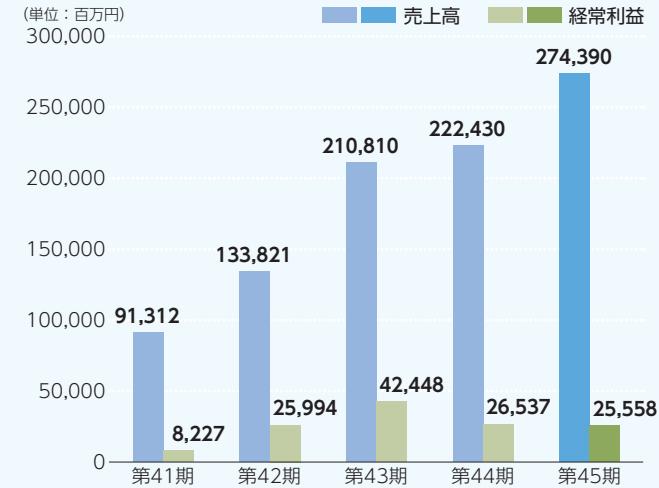
当社グループはこれからも事業成長を追求し、株主の皆さまにとって「成長する楽しみが持てる企業」であり続けるよう努めてまいります。

株主の皆さまにおかれましては、今後とも格別のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

2025年6月吉日

財務ハイライト

売上高／経常利益



1株当たり当期純利益



総資産／純資産



ROE(自己資本当期純利益率)／ROA(総資産経常利益率)



特集 1 2026年3月期～2028年3月期
中期経営計画アップデート

当社は3か年の中期経営計画をローリングアップデート(毎年次の3か年の計画を公表)することとしております。
 2025年3月期の振り返りとともに足許の状況を踏まえた中期経営計画の内容をお知らせします。

中期経営計画の振り返りとアップデート

2025年3月期の振り返り	事業成長	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 連結売上高2,744億円(前期比+23.4%)、営業利益241億円(前期比-3.1%)、半導体等装置、電子デバイス、車載の各SGの売上伸長、PV向け増堀・PVウエーハ受託生産事業の収益悪化及び生産拠点の新增設コスト負担あり、AI関連向けのサーモモジュール等好調も営業減益 ▶ 麗水工場の新設等、センサ事業への投資を推進
	生産効率・競争力強化	<ul style="list-style-type: none"> ▶ マレーシア・クリム工場(半導体関連)稼働開始、顧客認定進捗 ▶ マレーシア・ジョホール工場(パワー半導体基板)は2025年4月に竣工、顧客引合い強い ▶ 検査工程の自動化・AI化、倉庫や加工工程の自動化を実施、デジタル化・自動化が進捗 ▶ パワー半導体の基板材料開発、半導体セラミックスの製品レンジ拡大等が進展
	人材・企業文化	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 人材重視を重要な経営戦略と位置付け、幹部級の人材採用に注力、研修制度の拡充を実施 ▶ 「顧客を尊敬、従業員を尊敬し、勤勉と信用を尊重し、着実に行動し、革新を追求する」を指針に掲げ、企業文化の浸透を実施
	財務・株主還元等	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 株主還元を強化、新たに3.5%を下限とするDOEを採用、また自社株式の取得を機動的に検討し、総還元性向は50%を目指していく方針とした ▶ 中国上場の洗浄事業子会社FTSVAがパワー半導体基板子会社FLHを取得する計画を開示

2026年3月期～2028年3月期目標	事業成長	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 半導体関連、電子デバイス、自動車関連事業を拡大し、成長を追求する ▶ 米中摩擦による中国外製造(Ex-China)のニーズに対応してマレーシア等の中国外製造を強化しながら、中国における半導体関連ニーズの取込みを進める
	収益性向上・生産効率向上	<ul style="list-style-type: none"> ▶ マレーシア(クリム、ジョホール)工場の生産拡充・効率性向上による収益率の引上げ実現 ▶ デジタル化・自動化・AI化を展開し、生産効率向上・競争力強化を追求する ▶ 新製品・新技術の開発を推進・強化、「品質は命」と考え品質管理の徹底を継続
	人材・企業文化	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 人材重視を重要な経営戦略とし、人材の採用及び育成を推進 ▶ 企業文化は企業の礎であり、「顧客を尊敬、従業員を尊敬し、勤勉と信用を尊重し、着実に行動し、革新を追求する」指針の浸透活動を継続する
	財務・株主還元等	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 中国上場の洗浄事業子会社FTSVAとパワー半導体基板子会社FLHの統合実現後には株式時価が増加見通しであり、活用方法を検討する ▶ 新たな株主還元方針に則り、DOEを採用、自社株式の取得も機動的に検討する方針

中期経営計画KPI(ローリングアップデート)

● 足許の半導体関連需要の成長減速や投資等を織込み、計画を見直し

(金額の単位は百万円)	25/3期(実)	26/3期(予)	27/3期(計)	28/3期(計)
売上高	274,390	285,000	340,000	400,000
営業利益	24,089	28,000	35,000	47,000
営業利益率	8.8%	9.8%	10.3%	11.8%
当期純利益	15,692	16,000	20,000	29,000
ROE	7.1%			15%
ROIC ^{※1}	3.9%			8%
自己資本比率	39.4%	40%		
設備投資	51,776	65,000	45,000	30,000
1株当たり配当金(年間)	141.0円	148.0円	DOE(連結株主資本配当率 ^{※2})を採用し、下限を3.5%に設定 自社株式取得を機動的に検討、 総還元性向50%を目指す	

※1 ROIC = 親会社帰属純利益 + (有利子負債 + 純資産) / 純資産は新株予約権、非支配株主持分除く
 ※2 連結株主資本 = 資本金 + 資本剰余金 + 利益剰余金 - 自己株式、連結株主資本配当率 = 配当金総額 ÷ 連結株主資本

資産売却によるキャッシュ創出 - B/S強化

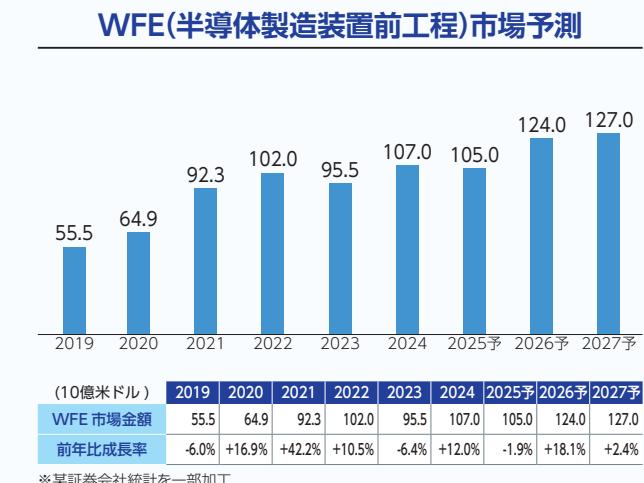
- 3か年の設備投資は累計1,400億円を計画
- 26/3期～28/3期、500億円以上のグループ資産(子会社株式等)を売却する方針
- 売却代金は、設備投資資金や自己株式の取得を含む株主還元へ充当する予定

26/3期～28/3期設備投資計画
設備投資総額：1,400億円
 (主要案件)
 マレーシアクリム第1工場機械設備投資
 マレーシアクリム第2工場投資
 マレーシアジョホール工場投資

市場環境

2025年の半導体市場は伸長も、WFEはほぼ横ばい

- WFEは中国向け輸出の減少等の影響で横ばい。米国における政策先行き見通せず足許は不透明も、中長期的には市場は伸長予測



特集
2

成長機会を取り込むとともに地政学リスク緩和に向けて

“Ex-China”体制の構築を推進

当社は、30年来中国への量産拠点づくりを集中して実施してきましたが、2022年以降の米中半導体摩擦の激化に伴い、欧米半導体製造装置メーカーによる中国外製造(Ex-China)のニーズに対応すべく、マレーシア、日本での量産拠点づくりを進めてまいりました。

2025年は、かねてより準備してきた製造拠点が次々と竣工し、生産を開始する段階となってきております。各拠点を円滑に立上げ収益貢献を果たせるよう努めてまいります。

🇲🇾 マレーシア

最も早期(2024年1月)に稼働開始したマレーシア北部のクリム第1工場(石英、セラミックス、金属受託加工)は、この1年で順調に立ち上がり、現在はフル生産となっております。また、この第1工場の生産能力で顧客需要と比較してまだ少ないとの判断により、クリム第2工場を建設することを決定しました。こちらは2026年秋ごろの竣工を目指して建設を進めます。

マレーシア南部ジョホールのパワー半導体基板の工場も2025年4月に無事竣工し生産を開始しました。この工場には、サーモジュールやパワー半導体基板の生産ラインも設置する予定です。

🇯🇵 日本

日本では石川第3工場(セラミックス)がまもなく竣工予定であり、既存工場も含め石川が国内では最も集積した生産拠点となります。また、熊本工場(部品洗浄)も今期中に竣工、生産開始予定であり、近隣の部品洗浄ニーズを取り込んでまいります。

▶ 主な工場新設・生産能力増強の状況

2026年以降はマレーシアおよび日本工場で中国外製造品の需要の完全取り込みを目指す

対象事業	所在地	2025	2026	2027	2028	2029	現在の生産能力 (億円)	最大生産能力想定 (億円)
① 金属加工 石英	マレーシア	本格生産			フル稼働		150	190
② セラミックス 装置組立	マレーシア		稼働開始	本格生産	フル稼働		0	240
③ パワー半導体基板	マレーシア	稼働開始	本格生産	フル稼働			70	130
④ セラミックス	日本 石川県	稼働開始	本格生産	フル稼働			100	140
⑤ 洗浄	日本 熊本県	稼働開始	少量生産	フル稼働			0	20

① クリム第1工場



② クリム第2工場



③ ジョホール工場



④ 石川第3工場



⑤ 熊本部品洗浄工場



特集 3 中国事業の状況

ここ数年中国半導体市場の発展は著しく、中国ローカル企業の事業規模拡大、技術水準の向上もあり半導体市場の中でも重要度がさらに増しております。

当社は1992年に中国に進出し、量産拠点づくりを行うとともに地元企業や行政とのつながりを大切にしながら事業基盤を築いてまいりました。中国ローカルの半導体関連の有力企業とは広く取引関係にあり、国内供給できる企業として有利なポジションを確保しております。

今後の事業運営ではEx-China投資とのバランスを取りながらも、事業機会をとらえ収益貢献できるよう拠点づくりをしてまいります。

青島部品洗浄工場

部品洗浄事業は中国国内の6都市、9拠点のサービス網を構築しておりますが、新たな拠点として山東省青島市に工場設置することを決定、この度2025年5月に青島工場が竣工いたしました。

本工場は他拠点で既に顧客となっていた有力企業から強いオファーを受け設立に至ったものです。顧客企業の当社サービスへの満足度と信頼関係が本拠点設置につながったことは非常に光栄なことであると感じております。これからも製品・サービスで顧客企業の成長を支えてまいります。



常山第4期工場投資

中国国内の既存の金属受託加工工場(杭州、常山)でも多くの顧客から認証を頂いているものの、現時点ではすべての顧客需要を満たすことができず、特に将来的に大型の真空チャンバー加工や装置組立の能力不足をどうカバーしていくかを検討し、常山地区での金属受託加工の生産能力増強を行うことを決定しました。

また、本事業は常山政府投資企業との合併事業となると同時に各種優遇政策や支援(固定資産補助、借入利息補助等)も得られる見込みです。これにより中国ローカルメーカー向け市場でのシェア拡大を図ってまいります。



麗水センサ工場

当社はセンサ事業を手掛ける子会社である株式会社大泉製作所とともにサーミスタ(温度センサ)の量産拠点づくりを浙江省麗水市に進めてまいりましたが、この夏に竣工予定となりました。本工場は建屋面積12万㎡、大泉製作所製品の「高い品質」とフェローテックグループが培ってきた「量産能力」を組合せるべく、モノづくりの面で自動化、AI化をはじめ様々なノウハウを投じていきます。

販売面でもEV、通信など中国内のフェローテックグループの顧客基盤への浸透にとどまらず、様々な分野へ拡大を図ります。本工場は今後のセンサ事業世界戦略の要となり、事業を大きく飛躍させたいと考えております。



麗水ウエーハ第2工場

シリコンウエーハ製造会社である杭州中欣晶圆半導体股份有限公司(CCMC)は、浙江省麗水市に12インチウエーハの研究開発とシリコンインゴットからの一貫製造を行う麗水第2工場を竣工し、2025年2月より稼働開始しております。本工場は建屋面積25万㎡、月産30万枚の生産能力を持ちます。

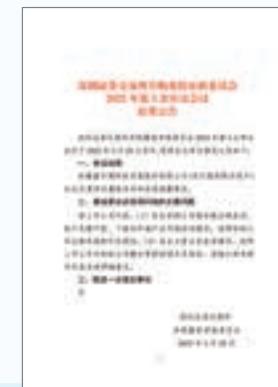
第1工場であるエピタキシャルウエーハ加工の専門工場と合わせ、麗水地区でシリコンウエーハの供給体制が増強されております。

CCMCは小口径から12インチウエーハ迄の幅広いラインナップを持ち、中国半導体国産化に寄与できる存在感のある企業となっております。



FTSVA-FLH合併

中国上場子会社(部品洗浄)である安徽富樂徳科技發展股份有限公司(FTSVA)はパワー半導体基板製造の子会社である江蘇富榮華半導体科技股份有限公司(FLH)を株式交換により合併するとして深セン証券取引所に申請しましたが、2025年5月29日に合併について「再編に関する条件および情報開示要件に適合している」との判断となり、同日に開示されました。本件により確実に合併へと進んでいくことが可能となりました。

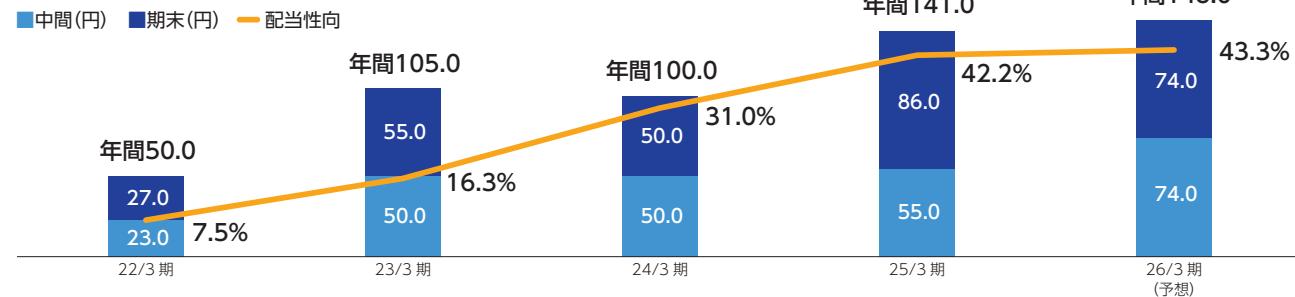


特集 4 株主還元と株価を意識した経営について

当社はこの度、新しい株主還元方針として、DOE(連結株主資本配当率)を採用、下限を3.5%とする旨を発表しました。これにより対前期で増配するとともに、今後の安定的な配当水準の維持を図ることができます。また、自社株式の取得も機動的に検討する方針としております。

下記は配当水準の推移と資本コスト・株価を意識した経営の実現に向けた取り組みの進捗状況を掲載しております。これら施策も含め、当社は適切な株価の実現に向けて努めてまいります。

1株当たり配当金の推移

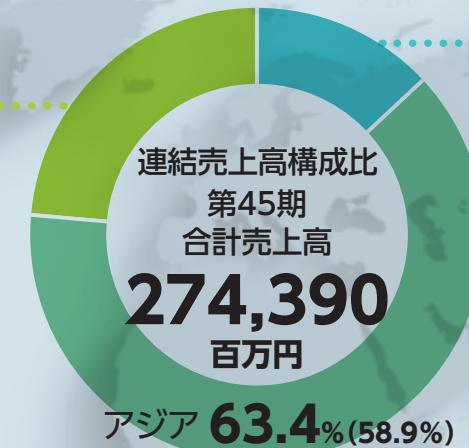


資本コスト・株価を意識した経営の実現に向けた取り組みの進捗

分類	項目	進捗
利益率	生産のデジタル化・自動化・AI化・見える化	検査の自動化・AI化、倉庫自動化等進捗 人員増加を抑制した生産増加を目指す
利益率、総資産回転率等	事業の選択と集中(事業の売却や非連結化)	一部事業の非連結化等進捗(交渉段階) PVウエーハ受託生産停止、PV増埧事業縮小
収益率、総資産回転率等	事業別・会社別ROIC管理、投資コントロール、 運転資本の圧縮	ROIC月次管理実施、社内の浸透が進展 在庫・運転資本の月次管理・削減推進を実施
財務レバレッジ等	新工場の早期稼働によるキャッシュフロー改善	クリム工場早期稼働に注力、月次黒字化 ジョホール工場は2025年4月竣工
財務レバレッジ	資金調達多様化	中国上場の洗浄事業子会社(FTSVA)がパワー 半導体基板子会社(FIH)を取得
資本コスト	自社株買い等株主還元の多様化の検討 サステナビリティ活動、IR活動強化	株主還元を強化、3.5%下限のDOEを採用 グループGHG(CO ₂)排出測定を実施
EPS期待成長率	米中摩擦に対応した中国外製造拠点の拡充	クリム工場の稼働開始、顧客認定進捗 米国顧客等の要請に対応、クリム第2工場着工

地域別売上高構成比

※()は前期の数字



欧米 23.5%(25.1%)

日本 13.1%(16.0%)



各エリア別のポテンシャル



欧米エリア

- 25/3期は前期比+15.7%の増収。半導体需要の回復から、大手製造装置メーカーからの設備発注再開に伴い、真空シール・金属受託加工や装置類の発注が伸長した。半導体マテリアル製品は顧客との中間在庫消化のためわずかな伸びとの想定だったが、セラミックスは比較的好調であった。
- 26/3期の欧米顧客向け売上は緩やかに増加するものと認識している。



アジアエリア

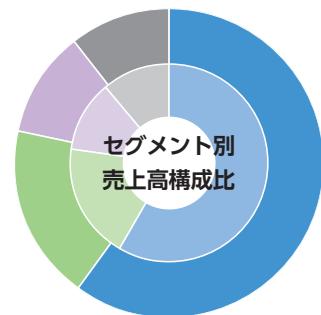
- 25/3期は前期比+32.8%の増収。昨年に引き続き、中国ローカルメーカー向け売上が下支となったことに加え、欧米顧客向けの需要回復もあり増収。電子デバイスも光トランシーバー向けサーモモジュールが伸長。車載関連も中国新エネルギー車の販売台数が伸びAMB基板等のパワー半導体基板が大きく伸びた。
- 26/3期も半導体等装置関連事業で中国国内メーカーからの需要は比較的堅調に推移すると見ている。



日本国内

- 25/3期は前期比+0.8%と微増。CVD-SiC製品が岡山工場の生産能力の増強もあり売上を伸ばしたものの、大泉製作所の決算期変更による減収により相殺された。
- 26/3期は年後半より稼働予定の石川、熊本の立ち上げを行い、収益貢献を目指す。

セグメント別事業概況



当社は、製品用途の類似性と販売先業種により区分し「半導体等装置関連事業」「電子デバイス事業」「車載関連事業」の3事業を報告セグメントとしております。

	第44期 (内周)	第45期 (外周)
半導体等装置関連事業	58.5%	60.2%
電子デバイス事業	18.8%	18.4%
車載関連事業	11.6%	11.1%
その他	11.1%	10.3%

半導体等装置関連事業

売上高 **1,652**億円 営業利益 **123**億円

半導体全体及び半導体製造装置の需要が回復基調のなか、当社の真空シール及び各種製造装置向け金属加工製品は米国メーカー、中国メーカーからの注文増などもあり大幅増収、半導体製造プロセスに使用される石英製品・セラミックス製品、部品洗浄サービスなども、工場稼働率の回復を背景に売上を伸ばしました。一方、石英坩堝については増収ながら、太陽光パネル製造メーカー向け売上が下期に停滞しました。利益面では、増産投資に伴う償却負担増、固定費増に加え、太陽光パネル製造向け石英坩堝の採算悪化などもあり、利益が伸び悩みました。



真空シール

電子デバイス事業

売上高 **504**億円 営業利益 **82**億円

サーモモジュールは、生成AI関連のサーバー投資の増加に伴い光トランシーバー向けの出荷が引き続き大きく伸びました。パワー半導体基板についても、産業機械向け等で順調に売上を伸ばしました。センサの損益は株式会社大泉製作所の決算期変更により、2024年4月から12月までの9か月分となっております。

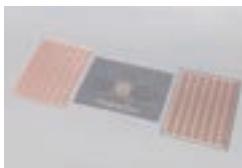


マイクロモジュール (光トランシーバー向け)

車載関連事業

売上高 **304**億円 営業利益 **35**億円

サーモモジュールは、前年同期比で車載用冷蔵庫等の販売を伸ばしました。パワー半導体基板については、電気自動車(EV)向けを中心に売上を伸ばし、全体では増収となりました。また、センサの損益は電子デバイス事業同様、株式会社大泉製作所の決算期変更の影響があります。利益面ではパワー半導体基板でDCB基板などの競争激化の影響から採算が低下しました。



AMB基板

※ 記載金額は、億円未満を切り捨てて表示しております。また、各セグメントの売上高は、外部顧客に対する数値を記載しております。

連結財務諸表(要約)

決算情報についての最新情報、詳細につきましては当社のIRサイトをご覧ください。
<https://www.ferrotec.co.jp/ir/>



連結貸借対照表

(単位:百万円)

科目	当期 2025年3月31日現在	前期 2024年3月31日現在
資産の部		
流動資産	295,367	248,408
固定資産	305,226	261,618
有形固定資産	245,064	201,339
無形固定資産	6,166	6,611
投資その他の資産	53,996	53,666
資産合計	600,593	510,026
負債の部		
流動負債	151,750	122,148
固定負債	125,292	109,712
負債合計	277,043	231,860
純資産の部		
株主資本	188,595	177,638
その他の包括利益累計額	48,235	26,771
非支配株主持分	86,718	73,756
純資産合計	323,549	278,166
負債純資産合計	600,593	510,026

※ 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

科目	当期 2024年4月1日から 2025年3月31日まで	前期 2023年4月1日から 2024年3月31日まで
営業活動による キャッシュ・フロー	26,066	28,720
投資活動による キャッシュ・フロー	△39,627	△92,400
財務活動による キャッシュ・フロー	18,965	60,419
現金及び現金同等物に係る 換算差額	6,687	4,162
現金及び現金同等物の 増減額(△は減少)	12,092	901
現金及び現金同等物の 期首残高	96,806	95,905
現金及び現金同等物の 期末残高	108,899	96,806

※ 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

連結損益計算書

(単位:百万円)

科目	当期 2024年4月1日から 2025年3月31日まで	前期 2023年4月1日から 2024年3月31日まで
売上高	274,390	222,430
売上原価	201,029	152,573
売上総利益	73,361	69,856
販売費及び一般管理費	49,271	44,984
営業利益	24,089	24,872
営業外収益	10,318	8,002
営業外費用	8,850	6,337
経常利益	25,558	26,537
特別利益	350	754
特別損失	862	1,145
税金等調整前当期純利益	25,046	26,146
法人税等	5,746	5,510
当期純利益	19,300	20,635
非支配株主に帰属する当期純利益	3,607	5,481
親会社株主に帰属する当期純利益	15,692	15,154

※ 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

連結包括利益計算書

(単位:百万円)

科目	当期 2024年4月1日から 2025年3月31日まで	前期 2023年4月1日から 2024年3月31日まで
当期純利益	19,300	20,635
その他の包括利益	28,497	13,063
その他有価証券評価差額金	△317	982
為替換算調整勘定	25,695	10,120
退職給付に係る調整額	239	177
持分法適用会社に対する持分相当額	2,881	1,784
包括利益	47,797	33,699
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	37,368	25,212
非支配株主に係る包括利益	10,429	8,486

※ 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

株式情報 / 会社情報 (2025年3月31日現在)

株式の状況

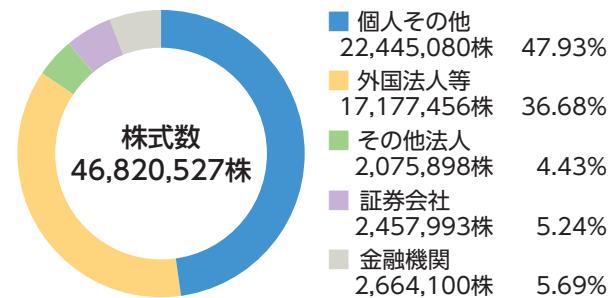
発行可能株式総数	100,000,000株
発行済株式総数	47,117,949株
株主数	42,604名

大株主

株主名	持株数(株)	持株比率(%)
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	2,320,266	4.95
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103	1,247,390	2.66
BNP PARIBAS SINGAPORE/2S/JASDEC/ UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED	1,200,000	2.56
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223	931,822	1.99
山村 清子	856,200	1.82
セントラル短資株式会社	657,900	1.40
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE	643,899	1.37
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234	614,200	1.31
SCBHK AC EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT SERVICES (HK)LIMITED-CLIENT AC	586,000	1.25
JP MORGAN CHASE BANK 385632	573,796	1.22

(注) 1. 当社は、自己株式297,422株を保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
2. 表示単位未満を切り捨てて表示しております。

所有者別株式分布状況



(注) 1. 自己株式297,422株は上記の円グラフ中の株式数に含まれておりません。
2. 表示単位未満を切り捨てて表示しております。

会社概要

商号	株式会社フェローテックホールディングス (英文表記) Ferrotec Holdings Corporation
設立	1980年9月27日
資本金	295億4,941万7,527円
株式公開	株式会社東京証券取引所 スタンダード 1996年10月18日(証券コード: 6890)
決算期	3月31日
従業員数	15,983名(連結)

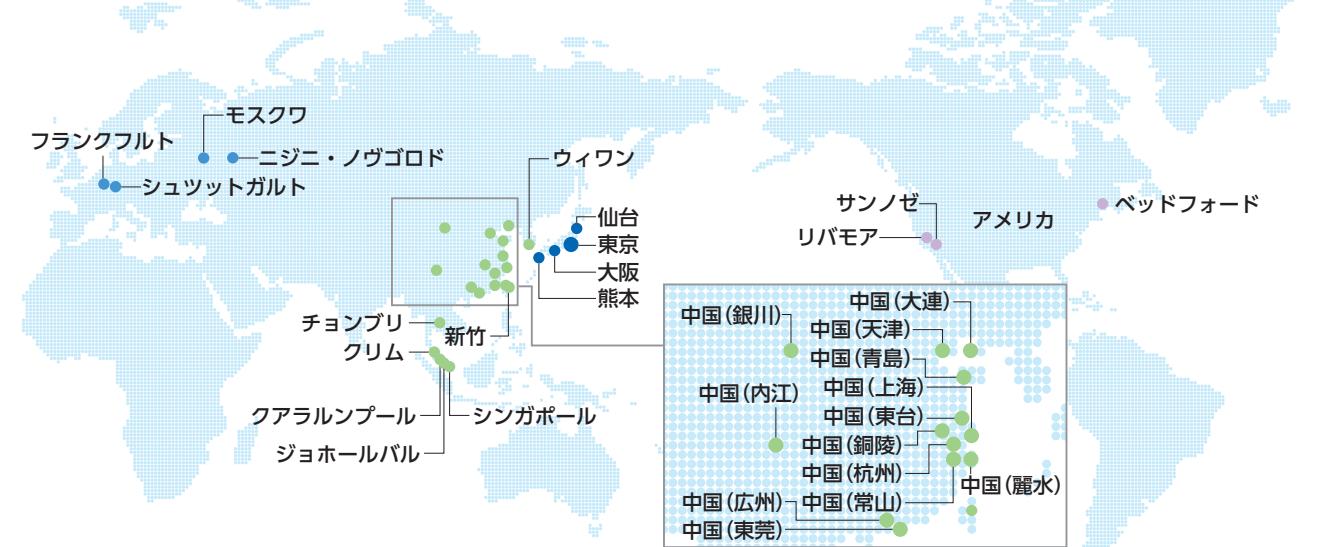
所在地

本社 〒103-0027
東京都中央区日本橋2-3-4
日本橋プラザビル5階

役員 (2025年6月27日現在)

役職	氏名
代表取締役社長	賀 賢 漢
代表取締役副社長	山 村 丈
取締役	並 木 美 代 子
取締役	武 田 明
取締役	佐 藤 昭 広
取締役	藤 本 健 太 郎
社外取締役	磯 巧
社外取締役	勝 田 裕 子
社外取締役	永 守 知 博
監査役	
常勤監査役	若 木 啓 男
社外監査役	松 本 拓 生
社外監査役	大 樂 弘 幸

グローバルネットワーク



欧州

- フランクフルト (ドイツ)
- シュツットガルト (ドイツ)
- モスクワ (ロシア)
- ニジニ・ノヴゴロド (ロシア)

アジア

- 杭州
- 上海
- 銀川
- 銅陵
- 東莞
- 東台
- 常山
- 天津
- 大連
- シンガポール
- 新竹 (台湾)
- ウィワン (韓国)
- クアラルンプール (マレーシア)
- クリム (マレーシア)
- ジョホールバル (マレーシア)
- チョンブリ (タイ)

日本

- 東京 [本社]
- 千葉
- 兵庫
- 石川
- 岡山
- 神奈川
- 大阪
- 仙台
- 山形
- 埼玉
- 青森
- 宮城
- 熊本

米国

- ベッドフォード
- リバモア
- サンノゼ

販売拠点 生産拠点